

芯联集成电路制造股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议将于 2024 年 6 月 21 日召开。作为公司的独立董事，我们于会前收到了本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断的立场，就本次董事会会议涉及的相关事宜发表事前认可意见如下：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方（以下单称或合称“交易对方”）合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“标的公司”）72.3333% 股权（以下简称“本次交易”）。我们已认真审阅董事会拟审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

1、本次交易的方案、公司拟签订的相关交易协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、具备可操作性，符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

2、本次交易有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，本次交易将进一步提高公司资产质量，提升市场竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

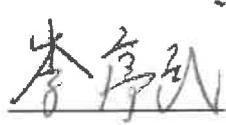
3、本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次交易相关的议案时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。

综上，我们一致同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Li Xuwu in black ink, written over a horizontal line.

李序武

2024年6月20日

（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：



李 生 校

2024年6月20日

（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李旺荣', written over a large, faint circular watermark or stamp.

李旺荣

2024年6月20日

（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：



史习民

2024年6月20日